

中信证券股份有限公司

关于中微半导体（深圳）股份有限公司

2023 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责中微半导上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与中微半导签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2023 年上半年度中微半导在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2023 年上半年度中微半导在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解中微半导经营情况，对中微半导开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证	2023 年上半年度，保荐机构督导中微半导及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、

序号	工作内容	实施情况
	券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促中微半导体依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对中微半导的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，中微半导的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促中微半导体严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对中微半导的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2023 年上半年度，中微半导体及其控股股东、实际控制人不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2023 年上半年度，中微半导体及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上	2023 年上半年度，经保荐机构核查，中微半导体不存在应及时向上海证券交易所报

序号	工作内容	实施情况
	市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2023 年上半年度，中微半导体未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年上半年度，中微半导体不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）技术风险

1、产品研发风险

公司作为芯片设计公司，为适应市场新需求和新变化，坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计的技术要求高、工艺复杂，且流片成本较高，若公司产品研发失败，存在前期投入资金无法收回的风险。

公司正在从事的主要研发项目包括大家电主控芯片研发项目、车规级 MCU 系列芯片研发项目、基于 55/40 纳米制程的芯片研发项目、下一代电机系列芯片项目等，上述新产品研发的开发周期较长、资金投入较大，若公司在产品规划阶段未能及时跟踪市场需求走向，或未能维持研发人员的稳定性及研发体系的稳健运作，或在研项目的下游产品技术路径、应用场景等未获市场认可，将对公司未来业绩造成一定影响；此外，若公司研发投入未能及时产业化、技术人才储备无法适应行业的技术形势，导致公司市场竞争中处于落后地位，无法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品，可能会对公司市场份额和核心竞争力产生一定影响。

2、技术泄密风险

集成电路设计行业技术密集型的特征日益凸显，拥有核心技术及高素质的研发人员是公司生存和发展的根本。若因核心技术人员流动、技术泄密，或知识产权措施不力等原因，造成公司核心技术流失，可能在一定程度上削弱公司的技术优势，对公司的核心竞争力产生不利影响。

（二）经营风险

1、供应商风险

公司属于 Fabless 模式集成电路设计公司，存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此行业集中度较高。如果公司的供应商发生不可抗力的突发事件或未能及时开拓新的供应商，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。报告期内，上游晶圆加工和封测产能充分释放，下游市场需求未能同步扩张，晶圆和封装测试趋于供大于求状态。

2、市场周期性的风险

公司 MCU 产品主要应用于家电、消费和工控与汽车电子领域，虽然工业控制领域占比逐年增加，汽车电子实现突破，但小家电和消费电子领域占比仍然较

高。受全球消费能力下降和整个市场周期性影响，家电行业的景气程度和下游客户经营情况会较大程度地影响公司芯片的使用需求。若未来家电和消费类市场需求萎缩，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

3、人才流失风险

芯片设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司新产品的研发以及技术能力的储备造成影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

(三) 财务风险

1、应收账款回收风险

报告期内，公司加大了应收账款管理力度，应收账款总量环比有所减少，但由于下游需求增长没有出现，公司为抢占市场，采取相对积极销售策略，应收账款体量仍然较大，如果未来公司无法及时收回应收账款，可能对公司的现金流和整体经营造成不利影响。

2、毛利率波动风险

受市场需求疲软和芯片行业去库存影响，公司 2023 年上半年毛利率下降至 19.99%，同比变动-26.63 个百分点。由于整体库存较高和下游需求增长承压，公司毛利率环比下滑，2023 年第二季度毛利率降至 18.42%，环比下滑 3.44 个百分点，对公司盈利水平带来不利影响。

3、税收优惠政策风险

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，后续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。由于研发投入加大，四川中微芯成预计今年能够达到国家鼓励的重点集成电路设计企业指标，获利年度未超过 5 年，按免征企业所得税

计提。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，将对公司的经营业绩产生一定影响。

4、存货跌价风险

公司存货主要由晶圆和芯片构成。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备。报告期内，公司一直坚持了对上游的采购规模，但由于下游需求增长承压，出货增长率没能超过采购增长率，公司库存仍有小幅增加；目前上游供应成本已经下调，库存产品成本与新订购产品成本出现倒挂；若未来市场出现长期不景气情况，使得产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

5、汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售和采购、以美元报价和结算的情况。随着公司总体业务规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

（四）行业政策风险

集成电路行业是国家经济发展的支柱型行业之一，我国目前已通过一系列法律法规及产业政策，从提供税收优惠、保护知识产权、提供技术支持等角度，大力推动行业发展。如果目前良好的行业政策环境发生负面变化，将对集成电路产业的发展产生一定的影响。除此之外，国际间的贸易摩擦，以及有关国家的贸易保护主义抬头以及美国近期通过的《芯片与科学法案》，可能会对公司的新品研发和营收产生影响。公司将继续重视市场、产品、供应链等方面的多元化布局，抓住供应链本土化的时机，实现公司业务快速发展。

（五）业绩下滑风险

2023年1-6月，公司实现营业收入28,821.20万元，较上年同比变动-30.45%；

实现归属于母公司股东的净利润 2,654.03 万元，较上年同比变动-40.51%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-1,589.20 万元，由盈转亏，较上年同比变动-114.27%。2023 年上半年，芯片原厂由于前期备货，库存均处于高水位，而下游需求复苏没有达到预期，行业竞争加剧，为抢占市场，纷纷采取积极的销售策略，致公司产品单价较上年同期下降明显。报告期内，公司出货量虽然同比实现小幅增长，但由于价格下降明显，营业收入同比下降幅度较大。受市场需求疲软和芯片行业去库存影响，若公司未能及时提供满足市场需求的产品和服务，或公司未能妥善处理快速发展过程中的经营问题，将导致公司未来营业收入产生波动，或因成本费用上升等因素导致净利润产生波动。此外，声光电科股票公允价值的潜在变动预计将影响公司归属于母公司股东的净利润。上述因素可能导致公司面临经营业绩持续下滑、短期内无法扭亏为盈的风险。

四、重大违规事项

2023 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年上半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)
营业收入	288,212,021.78	414,382,622.33	-30.45
归属于上市公司股东的净利润	26,540,258.97	44,610,457.84	-40.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,891,960.47	111,389,506.87	-114.27
经营活动产生的现金流量净额	-86,407,883.27	-229,831,576.80	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,035,839,877.02	3,188,001,445.88	-4.77
总资产	3,223,807,115.12	3,369,252,746.57	-4.32
主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.13	-46.15
稀释每股收益 (元 / 股)	0.07	0.13	-46.15
扣除非经常性损益后的基本每股	-0.04	0.33	-112.12

收益（元 / 股）			
加权平均净资产收益率（%）	0.83	3.35	减少2.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.50	8.36	减少8.86个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	19.19	11.73	增加7.46个百分点

1、2023 年上半年实现销售收入 28,821.20 万元，较去年同期下降 30.45%。2023 年上半年，芯片原厂由于前期备货，库存均处于高水位，而下游需求复苏没有达到预期，行业竞争加剧，为抢占市场，公司产品单价较上年同期下降明显。通过积极的销售策略，报告期内公司出货量虽然实现小幅增长，但营业收入较去年同期下降幅度较大。

2、2023 年上半年实现归属于上市公司股东的扣非净利润-1,589.20 万元，比去年同期下降 114.27%；2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润 2,654.03 万元，比去年同期下降 40.51%。主要原因为，受市场需求疲软和芯片行业去库存影响，公司 2023 年上半年毛利率下降至 19.99%，在出货量略有增长的情况下，营业收入较大幅度下滑。同时公司持续加大研发力度，研发费用较去年同期有明显增长，归属于上市公司股东的扣非净利润下降明显。归属上市公司股东净利润下降幅度较扣非净利润大幅度收窄，主要原因是公司持有的电科芯片股票产生的公允价值变动损益金额变化所致，报告期电科芯片股价上升造成公司半年度公允价值变动损益为 2,342.02 万元。

六、核心竞争力的变化情况

公司在芯片设计领域深耕 20 余年，不断拓展自主设计能力，积累的自主 IP 超过 1,000 个，具有技术全面、产品线丰富、人才团队建设完善、供应链保障度高的特点。

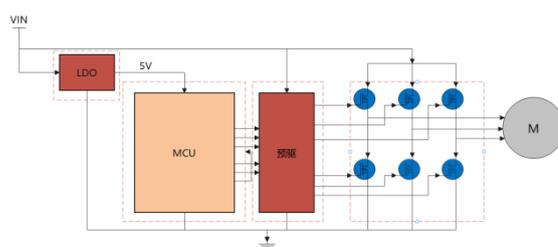
1、技术布局全、应用领域广

公司围绕智能控制器所需芯片和算法进行技术与产品布局，经过 20 余年的积累与拓展，掌握主流系列 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频、高性能触摸和底层核心算法的设计能力；产品在 55 纳米至 180 纳米 CMOS 工艺、90 纳米至 350 纳米 BCD、高压 700V 驱动、双极、SGT MOS、IGBT 等工艺制程上投产；全面的技术能力，使公司成为平台型的芯片设计企业，实现了

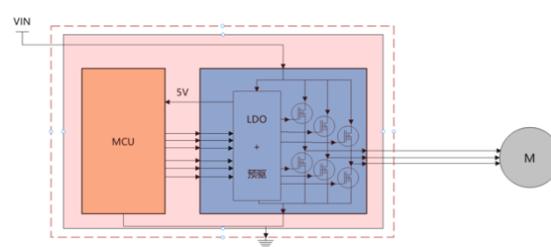
芯片的结构化和模块化开发，针对不同细分领域可快速推出具有竞争优势的产品，还可为客户提供差异化、定制化服务，满足细分领域客户对芯片功能、资源、性价比的差异化需求；产品广泛应用于家电、消费类、电机与电池、物联网、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域。

2、整合能力强、集成程度高

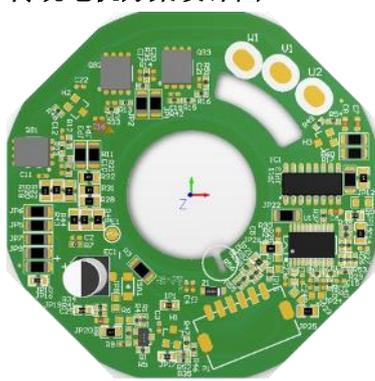
公司始终追求集成电路的本质，通过全面的设计技术（数字、模拟、功率器件设计能力）提升外围电子的整合能力、提高产品集成度，提高产品性能、降低综合成本，提升产品综合竞争力。以公司电机 SoC 芯片为例，与传统方案相比，公司单芯片集成了 MCU、LDO、预驱、3 颗（P+N）MOS，一颗芯片实现了传统方案 6 颗芯片的功能，公司电机方案与传统方案的设计图与实物图对比情况如下：



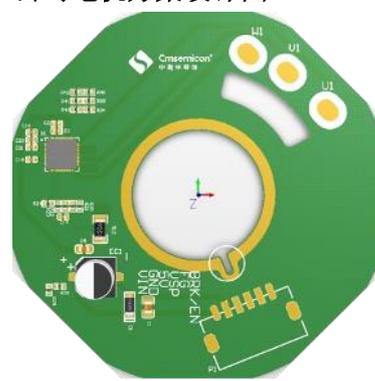
传统电机方案设计图



公司电机方案设计图



传统电机方案实物图



公司电机方案实物图

3、团队协同好、平台型开发

IC 设计行业是知识密集型行业，企业发展的关键因素是人才。公司结合不同城市的地域特点、人才储备优势和贴近市场需求进行研发团队的布局，并以打造成研发中心为契机，建设以中山、重庆、北京、上海、新加坡等技术团队为支撑的“一个中心、多点支撑”的空间布局，各团队分工合作。

公司以MCU为核心的研发平台成熟，自有IP过1000个，面向具体应用定义产品后进行模块化、结构化设计，新产品设计，开发边际成本低，开发周期短，市场导入快，新领域营收增长快。

4、合作程度深、产能保障好

公司与主要供应商稳定合作多年。长期合作所积累的信誉与共同增长的产能供给与需求，加深了公司与主要供应商之间的合作，形成了合作共赢、共同发展的战略合作伙伴关系，增强供应链合作黏性，在产能上得到较为稳定的保证。此外，公司在四川遂宁建设有产能调节型的封装测试产线，增强公司封装测试的应急能力和工程批芯片即封即测的能力，提高新产品研发验证效率。

5、产品应用经验丰富、产品定义贴近市场

创始团队从芯片应用开发走向芯片设计，公司继承了面向应用、贴近市场的基因，保持了强大的应用开发队伍对产品进行应用研究和对客户进行技术支持，促进公司产品快速推广，降低了客户开发难度，同时在对客户服务和交流中掌握终端产品的功能需求，并将获得的信息反馈给设计前端，使公司在新产品定义或升级换代中准确响应终端需求，设计出市场定位准、资源配置恰当、性能优越、性价比高、竞争力强的芯片产品。

6、产品系列全、客户群体多

公司产品系列全，包括通用MCU（8位、32位）、专用ASIC、混合信号SoC、功率器件等，应用领域广、市场空间大。公司产能在各产品线、领域中高效调节与配置，确保产能消耗和实现更大产能附加值；公司客户群体多，客户关系均衡，抗市场风险和持续盈利能力强。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入为5,531.15万元，占营业收入比例为19.19%。

单位：元

项目	2023年1-6月	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	55,311,499.42	48,605,141.02	13.80

资本化研发投入			
研发投入合计	55,311,499.42	48,605,141.02	13.80
研发投入总额占营业收入比例(%)	19.19	11.73	增加 7.46 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	不适用

报告期内，公司车规级 MCU BAT32A 系列产品进一步扩容，面向车身控制和汽车直流无刷电机应用的超高性价比产品 BAT32A233 已在多家 Tier1 内测，市场反应良好，预计 3 季度批量供货；国内首颗满足 AEC-Q100 Grade0 的产品 BAT32A337 在第三方机构 SGS 进行认证中，该产品将主要用于汽车热管理应用；公司面向空调室外机主控和工控领域的高性能 MCU 实现量产；公司面向工业控制类主控 MCU BAT32G127 系列实现量产，适用于三表、测量、IoT 应用，如水表、气表、热表、电压表、电流表、压力表以及燃气报警器可燃气体检测器等；公司发布具备多通道、双 AD 高精度 SoC CMS8H1215 产品，可广泛应用于消费电子、压力变送、家用医疗及工业测量等领域；公司发布针对紧凑级电机应用的高性价比 CMS32M65 芯片系列，满足工业级标准，适合对尺寸和成本敏感的智能家居、绿色骑行、白色家电、电动工具及工业电机控制等紧凑级电机应用；公司积极布局高端域控 MCU 芯片、半全桥驱动和预驱芯片，向着汽车芯片全国产解决方案迈进。

2023 年上半年，公司新申请发明专利 6 项，获得发明专利批准 6 项；新申请实用新型专利 1 项，获得实用新型专利批准 2 项；新申请软件著作权 11 项，获得软件著作权批准 2 项；新申请集成电路布图 3 项，获得集成电路布图批准 10 项。

截至报告期末，公司累计申请发明专利 59 项，获得授权的发明专利 28 项；累计申请实用新型专利 38 项，获得授权的实用新型专利 34 项；累计申请软件著作权 18 项，获得授权的软件著作权 16 项；累计申请集成电路布图 144 项，获得集成电路布图批准 144 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

2023年1-6月，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	181,650.09	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,293.68
	超募资金永久补流	B2	32,000.00
	利息收入净额	B3	946.23
本期发生额	项目投入	C1	1,476.17
	超募资金永久补流	C2	-
	利息收入净额	C3	1,801.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,769.85
	超募资金永久补流	D2=B2+C2	32,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	2,747.75
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	132,627.99	
实际结余募集资金	F	133,356.33	
差异[注]	G=E-F	-728.33	

[注]差异 728.33 万元由三部分构成：1.实际结余募集资金中包含以自筹资金预先支付发行费用金额 177.45 万元，公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，截止 2023 年 6 月 30 日，177.45 万元还在募集资金账户中理财，尚未转出；2.实际结余募集资金中 64.94 万元，系除上述已置换资金外以公司自筹资金支付的发行费用；3.项目投入与实际从募集账户付款支出的时间性差异 485.95 万元。

公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，中微半导对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，中微半导实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	任职	期末持股数量 (股)	持股比例 (%)	质押、冻结及减 持情况
1	YANGYONG	董事长、核心技术 人员	126,000,000	31.47	无
2	周彦	董事、总经理	91,800,000	22.93	无
3	王继通	董事、副总经理	-	-	-
4	LIUZEYU	董事、副总经理	-	-	-
5	罗勇	董事	16,200,000	4.05	无
6	陈凯	董事	-	-	-
7	华金秋	独立董事	-	-	-
8	吴敬	独立董事	-	-	-
9	宋晓科	独立董事	-	-	-
10	蒋智勇	监事会主席	16,200,000	4.05	无
11	周飞	监事	13,500,000	3.37	无
12	冯超	职工代表监事	-	-	-
13	MIAOXIAOYU	副总经理、核心 技术人员	-	-	-
14	李振华	副总经理、核心 技术人员	450,000	0.11	无
15	吴新元	董事会秘书、财 务总监	-	-	-

注：YANGYONG 直接持有公司 31.47% 的股份，通过顺为芯华间接持有公司股份，合计持有公司 33.03% 股份；王继通通过顺为芯华、顺为致远、重庆芯继间接持有公司股份；LIUZEYU 和 MIAOXIAOYU 通过顺为芯华间接持有公司股份；冯超通过顺为致远间接持有公司股份；李振华直接持有公司 0.11% 股份，并通过顺为致远间接持有公司股份；吴新元通过顺为致远、重庆芯继间接持有公司股份。

截至 2023 年 6 月 30 日，中微半导体实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

许艺彬

王彬

中信证券股份有限公司

2023年8月28日